

证券代码：688627

证券简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会
参与单位	尚融资本、浙江伟星资产、鞍钢集团资本、湖北省铁路发展基金、深圳市前海东华投资、南昌产投投资基金、山东省绿色资本、江西金控投资、西部证券、深圳中金岭南金汇资本、黑龙江辰能资本、广州开投智造产业投资、第一创业证券、华西银峰投资、财信证券、深圳市达晨财智创业投资、深圳望睿私募创业投资基金、上海毓盛私募基金、深圳市中科蓝讯科技、红土创业、国投瑞银、恒毅持盈（深圳）私募、信达澳亚基金、深圳国源信达资本、申万宏源、万和证券、恒生前海基金、上海宝弘景资产、惠升基金、深圳前海佳世财富、广发证券、Point72、长盛基金、长城基金、Oberweis Asset Management Inc、创金合信、深圳市嘉亿资产、远东宏信、前海开源资产、金圆资本管理、深圳市港壺实业、百嘉基金、顶石资本、深圳市高新投集团、长青藤资产、天演论（深圳）投资、越秀产业基金、前海宝创投资、国信证券、龙蟠科技、上海中域投资、源乘投资、善思投资、淳厚基金、国新投资、永安国富资产、江西潮望投资、上海淳阳私募基金
时间	2026年6月10日-6月11日
地点	公司会议室、深圳东海朗廷酒店

<p>接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书：彭娟</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、请公司介绍半导体测试领域当前发展趋势？</p> <p>当前半导体产业正经历深刻变革，人工智能、高带宽存储芯片等新兴领域推动 2.5D/3D 封装、Chiplet 等先进封装技术的快速发展，芯片内部结构日趋复杂，性能水平持续提升，相应对半导体测试设备的技术水平提出更高要求。目前，作为 AI 和 HPC 芯片中关键部分的 HBM 的测试逻辑已发生根本性变化。由于 HBM 堆叠层数高且与 GPU 深度绑定，测试模式已从传统的“抽样测试”转向“全深度测试”，这导致测试时间大幅延长，从而推高了测试设备的需求量。HBM 的复杂性和高价值属性使得存储测试设备需求呈现出技术升级和测试密度提升所带来的结构性增长机会。为了更好地满足客户对高端半导体测试设备日益增长的市场需求，公司需要持续提升高端半导体测试设备的产业化能力，进一步提升“设备平台+解决方案”的综合服务能力，巩固并提升公司在半导体测试设备领域的竞争力。</p> <p>二、请公司介绍当前市场拓展情况及后续规划？</p> <p>半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，国外龙头厂商凭借先发优势和持续高强度的研发投入已经形成一定的技术优势。公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业，以实现关键设备自主可控为核心目标，着力构建系统化全站点服务能力，在产品和技术方面具备较强的竞争优势。公司与国内头部半导体存储厂商建立了紧密稳定的业务合作关系，公司核心产品已应用于国内头部半导体厂商及其供应链，在市场上具有较强的竞争力，助力客户在</p>

降低测试成本、逐步实现供应链国产替代的同时提升生产质量，获得了客户的广泛认可。此外，公司本次募投项目立足于公司现有的核心技术体系，践行“量产一代、在研一代、预研一代”的可持续研发节奏，持续加强研发投入，夯实并持续推动核心技术发展，以满足下游客户在半导体测试领域的多样化、复杂化需求，进一步推动我国高端半导体存储测试设备的国产化进程。

三、请公司介绍在存储测试领域产品布局及技术优势？

在产品布局方面，公司以 DRAM 测试设备产品线为基础纵向延伸分选机、探针台等设备构建完整测试链，同步强化 HBM 及先进封装技术研究；依托 DRAM 技术储备横向拓展至 NAND FLASH 等存储测试领域，实现产品与技术的立体化布局。同时，依托公司在半导体存储测试设备领域成熟的产业化能力，助力研发成果的高效转化与精准落地，实现技术研发与市场需求的无缝衔接。在技术储备方面，公司持续致力于研发创新，以构建半导体领域的系统化测试检测设备平台为核心目标。目前，公司已积累了全栈关键技术模块，包括电子系统设计、软件算法、精密机械自动化等。各技术模块相互支撑，共同构建了适配半导体测试、晶圆检测等场景的完整技术平台，能够满足半导体测试领域的多样化需求，核心技术整体水平在国内处于领先地位，为公司在存储测试领域的研发创新提供了坚实技术支撑。

四、请问公司如何实现高端半导体测试领域的自主可控及供应链安全？

半导体测试设备核心主控芯片是决定测试精度、测试效率和测试功能覆盖的关键核心部件。核心主控芯片的自主可控是构建高性能半导体测试设备核心竞争力的基石。核心主

	<p>控芯片的自主可控不仅是突破高端技术壁垒、保障供应链安全的必要条件，更是降低测试成本、提升测试效率与市场竞争力的关键路径。ASIC 芯片具有高集成度、高测试速度、高测试精度、高可靠性和稳定性等特点，但芯片开发周期相对较长，具有较高的技术壁垒。国外龙头厂商的高端半导体测试设备主控芯片均采用专用 ASIC 芯片架构，以保证测试设备性能水平和稳定性。公司以实现高端半导体测试设备及关键核心部件自主可控为目标，通过自研高端半导体测试系统的核心主控芯片，实现关键核心技术突破，是公司重要的长期战略举措。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月 12 日